

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【公開番号】特開2002-261421(P2002-261421A)
 【公開日】平成14年9月13日(2002.9.13)
 【出願番号】特願2001-61797(P2001-61797)
 【国際特許分類第7版】

H 0 5 K 1/18
 B 4 2 D 15/10
 G 0 6 K 19/077

【F I】

H 0 5 K 1/18 P
 H 0 5 K 1/18 S
 B 4 2 D 15/10 5 2 1
 G 0 6 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月6日(2004.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1基材内へ電子部品を埋設し、埋設された上記電子部品の電極と電氣的に接続する回路パターンを上記第1基材の回路形成面に形成して上記電極と上記回路パターンとの電氣的接続を図る、ことを特徴とする電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項2】

上記第1基材内への上記電子部品の埋設後、上記回路パターン形成前に、埋設された上記電子部品の上記電極を上記回路形成面に露出させ、該露出後に上記回路パターンを形成する、請求項1記載の電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項3】

上記回路パターン形成後、該回路パターンを上記第1基材内へ押し込んで上記電氣的接続を図るとともに上記回路形成面を平坦化する、請求項1記載の電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項4】

樹脂材にてなる上記第1基材と、加熱された上記電子部品とを相対的に押圧することで上記第1基材内への上記電子部品の埋設を行ない上記回路パターンを形成する、請求項1から3のいずれかに記載の電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項5】

請求項1から4のいずれかに記載の電子部品実装済部品の製造方法を用いて電子部品実装済部品の製造した後、

上記電極と上記回路パターンとの上記電氣的接続後、上記第1基材の厚み方向から第2基材及び第3基材にて上記第1基材のラミネート処理を行なうことを特徴とする電子部品実装済完成品の製造方法。

【請求項6】

請求項5記載の、電子部品実装済完成品の製造方法にて製造されたことを特徴とする電

子部品実装済完成品。

【請求項7】

非接触ICカードを構成するため、上記回路パターンは、無線にて情報の送受信を行なうアンテナコイル形状にてなる、請求項6記載の電子部品実装済完成品。